

2014-2020年中国印制电路板(PCB) 行业监测与投资战略咨询报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2014-2020年中国印制电路板(PCB)行业监测与投资战略咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201408/110723.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，又称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接提供者。根据电路层数可分为单面板、双面板和多层板。常见的多层板一般为4层板或6层板，复杂的多层板可达十几层。

产业转移成就中国PCB产业大国，最重要的动力来源于成本和应用产业链两方面。在成本优势方面，中国在劳动力、土地、水电、资源和政策等方面具有巨大的优势；下游产业在中国的蓬勃发展，全球整机制造转移中国，提供了巨大的市场需求空间。中国由于下游产业的集中及劳动力、土地成本相对较低，成为发展势头最为强劲的区域。

2001年我国PCB行业总产值为360亿元，到2008年已经达到1183亿元，但是紧随其后的国际金融危机给全球PCB行业带来不小的震动，2009年全球PCB行业整体衰退程度达到16%，同样国内PCB行业也受到不小的冲击。2009年国内的家电下乡、3G拉动在一定程度上缓解了电子行业的压力，国内PCB行业总产值整体维持在千亿元之上。2009年，产值过10亿元的PCB企业为23家，总产值达到445亿元，占2009年国内PCB总产值近四成。

中国印制电路板业在内销增长和全球产能持续转移的形势下，将步入高速成长期。中国印制电路板的产业规模占全球比重到2014年将提高到41.92%。我国各类电子产品和LED等的兴起都对印制电路板行业产生强大的推动作用，未来五年中国印制电路板行业仍将保持快速增长。

报告目录

第一章 印制电路板（PCB）的相关概述

第一节 PCB的介绍

- 一、PCB的定义
- 二、PCB的分类
- 三、PCB的历史

第二节 PCB的产业链

- 一、PCB产业链的构成
- 二、产业链中的产品介绍

第二章 国际PCB产业发展分析

第一节 全球PCB产业发展概况

- 一、国际重点PCB制造企业发展概述
- 二、2012年全球PCB工业发展分析

- 三、2013年全球PCB行业发展分析
- 四、2013年全球PCB产业的格局变化
- 五、2013年国际柔性电路板行业的发展
- 六、国外印制电路板制造技术的发展
- 七、2013年全球PCB行业发展分析及预测

第二节 美国

- 一、美国PCB产业的发展概况
- 二、美国PCB主要生产厂家的发展
- 三、2013年北美印刷电路板发展现状

第三节 欧洲

- 一、欧洲PCB产业发展概况
- 二、2013年德国PCB产业的发展
- 三、2013年欧洲PCB行业发展分析

第四节 日本

- 一、日本PCB产业的发展阶段
- 二、日本PCB产业的发展回顾
- 三、2013年日本PCB产业的发展
- 四、日本领先PCB厂商发展高端路线

第五节 台湾地区

- 一、2012年台湾PCB产业的发展
- 二、2013年台湾PCB产业的发展
- 三、台湾PCB企业在大陆市场的发展动态

第三章 中国PCB产业发展分析

第一节 我国PCB产业的发展概况

- 一、我国PCB产业的产值及产能
- 二、我国PCB产业的产品结构
- 三、我国PCB行业配套日渐完善
- 四、2013年我国PCB行业的发展
- 五、2013年我国PCB产业的发展机遇

第二节 PCB产业竞争力分析

- 一、竞争对手
- 二、替代品

三、潜在进入者

四、供应商的力量

第三节 HDI市场发展分析

一、HDI市场容量

二、HDI市场供求

三、HDI市场趋势

第四节 我国PCB产业发展问题及对策

一、我国PCB产业与国外存在的差距

二、PCB产业发展面临的挑战

三、PCB产业持续发展的措施

四、PCB产业需发展民族品牌

第四章 PCB制造技术的研究

第一节 PCB芯片封装焊接方法及工艺流程的阐述

一、PCB芯片封装的介绍

二、PCB芯片封装的主要焊接方法

三、PCB芯片封装的流程

第二节 光电PCB技术

一、光电PCB的概述

二、光电PCB的光互连结构原理

三、光学PCB的优点

四、光电PCB的发展阶段

第三节 PCB技术的发展趋势

一、向高密度互连技术方向发展

二、组件埋嵌技术的发展

三、材料开发的提升

四、光电PCB的前景广阔

五、先进设备的引入

第五章 PCB上游原材料市场分析

第一节 铜箔

一、铜箔的相关概述

二、铜箔在柔性印制电路中的应用

三、电解铜箔产业的发展概况

第二节 环氧树脂

- 一、环氧树脂的相关概述
- 二、环氧树脂的主要应用领域
- 三、我国环氧树脂产业的发展现状

第三节 玻璃纤维

- 一、玻璃纤维的相关概述
- 二、我国成为全球最大玻璃纤维生产国
- 三、2013年我国玻璃纤维行业经济运行情况
- 四、2013年玻璃纤维产业的发展情况

第六章 PCB下游应用领域分析

第一节 消费类电子产品

- 一、2013年我国消费电子产品走向高端
- 二、消费电子用PCB市场需求稳定增长
- 三、高端电子消费品市场需求带动HDI电路板趋热

第二节 通讯设备

- 一、2013年我国通讯设备制造业发展情况
- 二、2013年我国通信设备业的发展
- 三、语音通讯移动终端用PCB的发展趋势

第三节 汽车电子

- 一、PCB成为汽车电子市场的热点
- 二、多优点PCB式汽车继电器市场不断壮大
- 三、2013年全球汽车电子PCB市场发展预测

第四节 LED照明

- 一、2013年中国LED照明的发展状况
- 二、LED发展为PCB行业带来新需求

第七章 国外重点PCB制造商介绍

第一节 日本企业

- 一、日本揖斐电株式会社(IBIDEN)
- 二、日本旗胜 (Nippon Mektron)
- 三、日本CMK公司

第二节 美国企业

- 一、MULTEK

二、美国TTM

三、新美亚（SANMINA-SCI）

四、惠亚集团（Viasystems）

第三节 韩国企业

一、三星电机（Samsung E-M）

二、永丰（Young Poong Group）

三、LG Electronics

第四节 台湾企业

一、欣兴电子

二、健鼎科技

三、雅新电子

第八章 国内PCB上市公司介绍

第一节 沪电股份

一、公司简介

二、2012年沪电股份经营状况分析

三、2013年沪电股份经营状况分析

第二节 天津普林

一、公司简介

二、2012年天津普林经营状况分析

三、2013年天津普林经营状况分析

第三节 生益科技

一、公司简介

二、2012年生益科技经营状况分析

三、2013年生益科技经营状况分析

第四节 超声电子

一、公司简介

二、2012年超声电子经营状况分析

三、2013年超声电子经营状况分析

第五节 超华科技

一、公司简介

二、2012年超华科技经营状况分析

三、2013年超华科技经营状况分析

第六节 上市公司财务比较分析

- 一、盈利能力分析
- 二、成长能力分析
- 三、营运能力分析
- 四、偿债能力分析

第九章 2014-2020年PCB行业投资分析及前景预测

第一节 2014-2020年PCB投资分析

- 一、PCB行业SWOT分析
- 二、PCB投资面临的风险
- 三、PCB市场投资空间大

第二节 2014-2020年PCB产业发展前景预测

- 一、2013年PCB产业的发展前景
- 二、2013年软板与HDI板发展前景向好
- 三、2014-2020年我国印制电路板产业的发展前景预测
- 四、未来我国PCB行业将保持高速增长
- 五、十二五期间我国PCB产业的发展重点

图表目录

图表：各国家/地区PCB工厂数目

图表：2012年全球不同种类PCB的增长率（按产品类型分）

图表：2012年电子整机及PCB的应用领域和未来发展

图表：2012年全球各国PCB产值

图表：2012年电子工业（半导体）和PCB工业的增长

图表：2013年全球各地区PCB产值分布

图表：2013年全球主要手机PCB板厂家市场占有率

图表：2000年和2013年全球PCB下游应用比例

图表：2000年和2013年全球PCB产品结构

图表：美国PCB产值变化情况

图表：日本PCB产量统计表

图表：日本PCB厂家海外产值（按产品类型分类）

图表：日本PCB厂家海外产值（按国家分类）

图表：日本PCB进出口量（按国别统计）

图表：日本PCB出口量（按地区统计）

图表：2010-2013年日本印刷电路板设备投资额

图表：2012年台湾PCB的资本构成

图表：2012年台湾不同种类PCB的比例

图表：台湾PCB市场规模

图表：2013年中国PCB产业主要本土企业销售收入增长幅度

图表：光学PCB和传统PCB的优点对比

图表：压延退火方法制造的铜箔产品

图表：铜箔的分类

图表：电解铜箔制造过程示意图

图表：铜箔的处理阶段和稳定性

图表：环氧树脂胶粘剂的主要用途

图表：2012-2013年华东环氧树脂市场走势图

图表：2007-2013年华东环氧树脂市场走势图

图表：2013年全国玻璃纤维纱累计产量

图表：2013年玻纤及制品主要进口来源地

图表：2012年7月-2013年9月玻璃纤维及制品当月出口量

图表：2013年通信设备制造业工业销售情况

图表：2013年我国通信设备产品产量及增长

图表：2013年我国通讯设备主要出口产品增长情况

图表：2013年我国通讯设备主要进口产品增长情况

图表：2013年通信设备制造业、计算机及其他电子设备制造业投资情况

图表：2013年通信设备制造业不同所有制企业经营情况

图表：2013年通信设备制造业不同规模企业经营情况

图表：全球手机销售量与Smart Phone市场渗透率

图表：2013年国内LED产量、芯片产量及芯片国产率

图表：2003-2013年我国LED市场规模及增长率变化

图表：2003-2013年我国LED封装产量变化

图表：2013年我国半导体照明应用领域

图表：2013年9月国内外功率型白光LED技术指标对比

图表：2013年沪电股份主营构成表

图表：2010-2013年沪电股份流动资产表

图表：2010-2013年沪电股份长期投资表

图表：2010-2013年沪电股份固定资产表
图表：2010-2013年沪电股份无形及其他资产表
图表：2010-2013年沪电股份流动负债表
图表：2010-2013年沪电股份长期负债表
图表：2010-2013年沪电股份股东权益表
图表：2010-2013年沪电股份主营业务收入表
图表：2010-2013年沪电股份主营业务利润表
图表：2010-2013年沪电股份营业利润表
图表：2010-2013年沪电股份利润总额表
图表：2010-2013年沪电股份净利润表
图表：2010-2013年沪电股份每股指标表
图表：2010-2013年沪电股份获利能力表
图表：2010-2013年沪电股份经营能力表
图表：2010-2013年沪电股份偿债能力表
图表：2010-2013年沪电股份资本结构表
图表：2010-2013年沪电股份发展能力表
图表：2010-2013年沪电股份现金流量分析表
图表：2013年沪电股份非经常性损益项目及金额
图表：2013年天津普林主营构成表
图表：2010-2013年天津普林流动资产表
图表：2010-2013年天津普林长期投资表
图表：2010-2013年天津普林固定资产表
图表：2010-2013年天津普林无形及其他资产

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201408/110723.html>